

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月28日(28.08.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/177663 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *C09J 7/38* (2018.01)
B32B 27/00 (2006.01) *C09J 133/00* (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01) *C09J 163/00* (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01) *H01L 21/304* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/042588

(22) 国際出願日: 2024年12月2日(02.12.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2024-023865 2024年2月20日(20.02.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).

(72) 発明者: 川 俣 龍 太 (KAWAMATA Ryuta); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP).

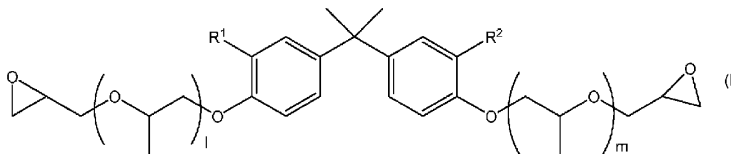
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: BONDING TAPE FOR SEMICONDUCTOR, METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR CHIP WITH ADHESIVE LAYER, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体用接着テープ、接着剤層付き半導体チップの製造方法、及び、半導体装置の製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a bonding tape for a semiconductor, the bonding tape comprising: a film-like adhesive; and an adhesive tape that is attached to the film-like adhesive. The film-like adhesive contains an epoxy resin and a curing agent. The epoxy resin includes an epoxy resin that is in a liquid state at 25 ° C, and the epoxy resin that is in a liquid state at 25 ° C contains a compound represented by formula (I). (In formula (I), R¹ and R² each independently represent a hydrogen atom or a glycidyl group, and l and m each represent an integer of 0 or more. In cases where R¹ and R² are hydrogen atoms, at least one of l and m is 1 or more.)

(57) 要約: フィルム状接着剤と、該フィルム状接着剤に貼り付けられた粘着テープと、を備え、フィルム状接着剤が、エポキシ樹脂と、硬化剤と、を含有し、エポキシ樹脂が、25℃で液状のエポキシ樹脂を含み、25℃で液状のエポキシ樹脂が下記式(Ⅰ)で表される化合物を含む、半導体用接着テープ。〔式(Ⅰ)中、R¹及びR²は、それぞれ独立して、水素原子又はグリシジル基を表し、l及びmは0以上の整数を表す。ただし、R¹及びR²が水素原子である場合は、l及びmの少なくとも一方は1以上である。〕

[続葉有]

WO 2025/177663 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）